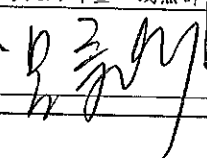
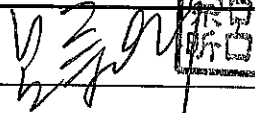
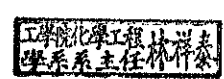


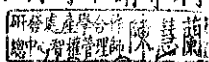


國立臺灣大學 研究成果教師自費申請專利表

提案人 (發明人代表)	姓名及職稱：呂宗昕教授 提案單位(系/所/中心)：台大化工系	
計畫 合作機構	無 (本申請案所屬之經費來源，如：科技部、經濟部、農委會等外部機構)	■利用本校資源(無計畫) (所執行者為校內計畫，或無計畫)
計畫名稱 及編號	(衍生本申請案之所有計畫，並附核定清單或契約書影本)	計畫主持人 簽章 
計畫合作期限 及金額	自 年 月 日至 年 月 日；共新台幣 元整	
申請專利名稱	氧化鈾粉體製備技術	
擬申請之國家	■中華民國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
自行申請專利 理由	因該技術有多家企業有興趣，為爭取技術智權先機，在時間緊急下，故擬自行申請專利。 ※請於完成專利申請程序後，主動提供專利申請書、專利說明書、專利申請日、專利申請號等資訊(可向事務所索取)。	
專利管理	擬(已)委任_____ (請填寫事務所名稱)撰稿、管理	
新創意願	是否有意願以本案技術辦理新創？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
附件 (*為必要文件)	<input checked="" type="checkbox"/> *技術分類表(附件一)； <input checked="" type="checkbox"/> *研究成果專利發明人資料表(附件二)； <input checked="" type="checkbox"/> *發明人專利申請權讓與同意書(附件三)； <input checked="" type="checkbox"/> *技術說明表(附件四)； <input checked="" type="checkbox"/> *教師自費申請專利合約書(附件五，一式兩份) <input type="checkbox"/> *個案委任書/狀(請事務所提供，並留欄位以供填寫『臺大案號』)； <input type="checkbox"/> *計畫經費核定清單(科技部計畫)或研究計畫補助合約書影本(非科技部計畫) <input type="checkbox"/> 學位論文口試秘密同意書影本。	
提案人：	 (親簽) 提案日期：2021年7月10日	
案件聯絡人(■同提案人)：	呂宗昕 先生/小姐 單位：化工系 電話：23654128 E-mail：chlu@ntu.edu.tw	
敬 陳		
系(中心)主任/所長		
院長/校級中心主任	 	

研發處(產學合作總中心)

擬依自行申請專利報備程序辦理



(後會)文書組

【請於「教師自費申請專利合約書」兩份、「個案委任書/狀」一份用完印後，送回產學合作總中心】

填表說明

1. 依專利法第七條規定與本校聘書內容，提案人之各專利案的專利申請權及專利權，皆屬本校所有；於自費申請專利時，除中國大陸專利外，請以『國立臺灣大學』為唯一專利申請人或專利權人，並請務必持續維護專利權。
2. 專利獲證後必須將專利證書交給產學合作總中心登列財產。

附件一、技術分類表

本校案號：06B-210703

(由產學合作總中心填寫)

(請依技術本質勾選(可複選)或於其他(請自填)欄位填入適當類別；分類結果將置於網頁)

一階	二階	三階
生醫 農健	農業	<input type="checkbox"/> 植物種苗 <input type="checkbox"/> 動物種苗 <input type="checkbox"/> 生物農藥 <input type="checkbox"/> 生物肥料 <input type="checkbox"/> 抗病/蟲/逆境性 <input type="checkbox"/> 生物整治 <input type="checkbox"/> 品種權 <input type="checkbox"/> 生物機電 <input type="checkbox"/> 組織培養 <input type="checkbox"/> 觀賞 <input type="checkbox"/> 發酵 <input type="checkbox"/> 基因轉殖 <input type="checkbox"/> 糧食 <input type="checkbox"/> 蔬菜 <input type="checkbox"/> 天然物利用 <input type="checkbox"/> 遺傳育種 <input type="checkbox"/> 森林學 <input type="checkbox"/> 獸醫學 <input type="checkbox"/> 膳食補充劑與保健食品 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	醫療器材	<input type="checkbox"/> 診斷與監測用器材 <input type="checkbox"/> 體外診斷用器材 <input type="checkbox"/> 手術與治療用器材 <input type="checkbox"/> 輔助與彌補用器材其他類醫療器材 <input type="checkbox"/> 疼痛管理器材 <input type="checkbox"/> 低/非侵入性器材 <input type="checkbox"/> 預防疾病與健康促進之設備及用品 <input type="checkbox"/> 醫學影像分析 <input type="checkbox"/> 骨替代材 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	篩選平台	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 生物晶片 <input type="checkbox"/> 細胞分析 <input type="checkbox"/> 組合式分子生物 <input type="checkbox"/> 組合化學 <input type="checkbox"/> 高通量藥物篩選技術(HTS) <input type="checkbox"/> 蛋白酶 <input type="checkbox"/> 藥物篩選 <input type="checkbox"/> 標靶藥物 <input type="checkbox"/> 噬菌體展示技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	藥物	<input type="checkbox"/> 止痛藥 <input type="checkbox"/> 麻醉劑 <input type="checkbox"/> 血管生成 <input type="checkbox"/> 消炎 <input type="checkbox"/> 抗生素 <input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 抗癌 <input type="checkbox"/> 抗真菌 <input type="checkbox"/> antisense <input type="checkbox"/> 抗病毒 <input type="checkbox"/> 細胞凋亡 <input type="checkbox"/> 細胞訊息 <input type="checkbox"/> 中樞神經系統 <input type="checkbox"/> 疾病模型 <input type="checkbox"/> 藥物輸送 <input type="checkbox"/> 生育 <input type="checkbox"/> 基因治療 <input type="checkbox"/> 賀爾蒙 <input type="checkbox"/> 免疫治療 <input type="checkbox"/> 發炎 <input type="checkbox"/> 新陳代謝 <input type="checkbox"/> 天然物 <input type="checkbox"/> 病原體 <input type="checkbox"/> 胜肽 <input type="checkbox"/> 前驅藥物 <input type="checkbox"/> 蛋白質 <input type="checkbox"/> RNAi <input type="checkbox"/> 小分子藥物 <input type="checkbox"/> 疫苗 <input type="checkbox"/> 病毒 <input type="checkbox"/> 傷口癒合 <input type="checkbox"/> 美容 <input type="checkbox"/> 疼痛管理 <input type="checkbox"/> 疾病防治 <input type="checkbox"/> 幹細胞 <input type="checkbox"/> 保健食品 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	基因體學	<input type="checkbox"/> allele <input type="checkbox"/> 生物資訊學 <input type="checkbox"/> cDNA <input type="checkbox"/> DNA <input type="checkbox"/> 流行病學 <input type="checkbox"/> EST <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 基因型 <input type="checkbox"/> homologue <input type="checkbox"/> isogene <input type="checkbox"/> 基因庫 <input type="checkbox"/> 微陣列/微陣列分析軟體 <input type="checkbox"/> 藥物基因體學 <input type="checkbox"/> 聚合酶 <input type="checkbox"/> 多型性 <input type="checkbox"/> 定位選殖 <input type="checkbox"/> 蛋白質體學 <input type="checkbox"/> 受體 <input type="checkbox"/> RNA <input type="checkbox"/> 標靶驗證 <input type="checkbox"/> 基因轉殖動物 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	研究工具	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 細胞株 <input type="checkbox"/> 色層分析 <input type="checkbox"/> 細胞培養 <input type="checkbox"/> 定向分子演化 <input type="checkbox"/> DNA/RNA 定序 <input type="checkbox"/> DNA/RNA 合成 <input type="checkbox"/> 電泳 <input type="checkbox"/> 酵素 <input type="checkbox"/> 裝置 <input type="checkbox"/> 表現系統 <input type="checkbox"/> 雜交 <input type="checkbox"/> 老鼠模式 <input type="checkbox"/> 寡核苷酸合成 <input type="checkbox"/> PCR 檢測 <input type="checkbox"/> 蛋白酶 <input type="checkbox"/> 蛋白質定序 <input type="checkbox"/> 蛋白質合成 <input type="checkbox"/> 試劑 <input type="checkbox"/> RNAi <input type="checkbox"/> 光譜 <input type="checkbox"/> 載體 <input type="checkbox"/> 蛋白質定量工具 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	技術	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 生物晶片 <input type="checkbox"/> 顯影劑 <input type="checkbox"/> DNA 探針 <input type="checkbox"/> 造影成像 <input type="checkbox"/> 分子標記 <input type="checkbox"/> 放射性同位素 <input type="checkbox"/> 檢測技術 <input type="checkbox"/> 純化/萃取 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
電資 通光	電子光電	<input type="checkbox"/> 光資訊技術 <input type="checkbox"/> 光電半導體技術 <input type="checkbox"/> 平面顯示技術 <input type="checkbox"/> 背光技術 <input type="checkbox"/> 軟性電子技術 <input type="checkbox"/> 光學技術(含鏡片材料) <input type="checkbox"/> 電子及光電構裝技術 <input type="checkbox"/> 矽基半導體技術 <input type="checkbox"/> 電磁/光電訊號檢測 <input type="checkbox"/> 奈米電子技術 <input type="checkbox"/> 電子元件散熱技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	資訊通訊	<input type="checkbox"/> 有線網路 <input type="checkbox"/> 語音 <input type="checkbox"/> 資訊安全 <input type="checkbox"/> 監控 <input type="checkbox"/> 網際網路電話相關技術(VoIP) <input type="checkbox"/> Web 相關技術 <input type="checkbox"/> 智慧型資訊系統 <input type="checkbox"/> 無線通訊技術 <input type="checkbox"/> 射頻辨識技術及應用(RFID) <input type="checkbox"/> 環境控制與感知技術 <input type="checkbox"/> 數位視/音訊與多媒體技術 <input type="checkbox"/> 光通訊技術 <input type="checkbox"/> 電子商務 <input type="checkbox"/> 嵌入式系統技術 <input type="checkbox"/> 異質整合系統、記憶體子系統 <input type="checkbox"/> 處理器架構、編譯器技術 <input type="checkbox"/> GPU 技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
機能 材化	材料化工	<input type="checkbox"/> 添加劑 <input type="checkbox"/> 觸媒 <input type="checkbox"/> 塗料/塗佈 <input type="checkbox"/> 電化學 <input type="checkbox"/> 石墨烯 <input type="checkbox"/> 導電高分子 <input type="checkbox"/> 塑料/聚合/複合材料 <input type="checkbox"/> 化學/生物分析 <input type="checkbox"/> 奈米材料 <input type="checkbox"/> 半導體材料/製程 <input type="checkbox"/> 物料改質 <input type="checkbox"/> 超導體 <input type="checkbox"/> 分散均勻化 <input type="checkbox"/> 光學薄膜 <input type="checkbox"/> 藥物製程 <input type="checkbox"/> 有機合成 <input type="checkbox"/> 純化/分離程序 <input type="checkbox"/> 鐵磁性材料 <input type="checkbox"/> 材料合成及精密成形 <input type="checkbox"/> 軟磁材料 <input type="checkbox"/> 鋼鐵材料 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	能源環工	<input type="checkbox"/> 替代/生質能源 <input type="checkbox"/> 燃料電池 <input type="checkbox"/> 化學/生物分析 <input type="checkbox"/> 高電功率 <input type="checkbox"/> 碳氫化合物 <input type="checkbox"/> 儲能 <input type="checkbox"/> 節能減碳 <input type="checkbox"/> 太陽能/電池 <input type="checkbox"/> 海洋工程 <input type="checkbox"/> 醫學/診斷/器械/儀器 <input type="checkbox"/> 環境整治 <input type="checkbox"/> 土木工程 <input type="checkbox"/> 水利工程 <input type="checkbox"/> 感測/量測方法/系統 <input type="checkbox"/> 生醫材料 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	機械儀設	<input type="checkbox"/> 機械元件/裝置/設備 <input type="checkbox"/> 分析儀器 <input type="checkbox"/> 光學/激光機器人 <input type="checkbox"/> 顯微技術 <input type="checkbox"/> 導航(GPS) <input type="checkbox"/> 光譜儀 <input type="checkbox"/> 超音波 <input type="checkbox"/> 電腦輔助設計/檢測 <input type="checkbox"/> 圖像處理 <input type="checkbox"/> 環境感測/感應器 <input type="checkbox"/> 生理訊號感測 <input type="checkbox"/> 致動器 <input type="checkbox"/> 微機電/元件/系統 <input type="checkbox"/> 微控制 <input type="checkbox"/> 手機支援輔助系統 <input type="checkbox"/> 3D 積層製造 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
其他 (請自填)		

附件二、國立臺灣大學研究成果專利發明人資料表

本校案號：06B-210703

(由產學合作總中心填寫)

※發明人欄位填寫說明：

(1)發明人超過五位時，請自行複製發明人欄位使用。

(2)發明人請填寫實際的發明人，參酌美國專利實務上的認定，所謂發明人必須是對發明概念之形成及至少一項申請專利範圍之標的有所貢獻之人，才能稱為發明人。美國專利法規定，若列名之發明人未有發明之事實，則不得取得專利；若發明人記載錯誤，且可證明有「欺瞞之意圖」，則此專利權無法主張權利（單純接受指示，依所設計之實驗完成實驗結果者、提出需求者、提出產品缺點者等無實質貢獻者，不能算是發明人）。

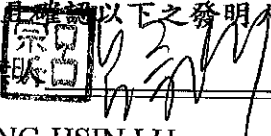
(3)未來收益分配之有功人員不限於此專利申請案所列之實際發明人。

※※注意事項一

1. 若提案後本案需變更發明人名單，則變更前後之各發明人皆需先簽署並提供同意書與校方後，由校方承辦人通知事務所變更發明人名單；

2. 上述變更所衍生之費用，由提案人全額支付。

3. 提案人同意本注意事項，且確認以下之發明人名單真實正確。

提案人  (親簽) 2021 年 7 月 10 日

發明人	1	姓名	呂宗昕/CHUNG-HSIN LU		
		服務單位	國立臺灣大學化學工程系	職稱	教授
		e-mail	chlu@ntu.edu.tw	電話	02-23651428
	2	姓名	(中文/英文)		
		服務單位		職稱	
		e-mail		電話	
	3	姓名	(中文/英文)		
		服務單位		職稱	
		e-mail		電話	
	4	姓名	(中文/英文)		
		服務單位		職稱	
		e-mail		電話	
	5	姓名	(中文/英文)		
		服務單位		職稱	
		e-mail		電話	

附件三、國立臺灣大學 發明人專利申請權讓與同意書

本校案號：06B-210203
(由產學合作總中心填寫)

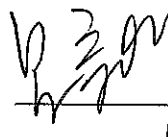

氧化鈷粉體製備技術 (請填寫首頁之「申請專利名稱」，以下簡稱為「本技術」) 之發明人等同意將其專利申請權讓與國立臺灣大學，另由發明人 呂宗昕 (任職單位 化工系) 擔任本技術之發明人代表(即提案人)，以就本技術進行下述事宜—

- (1) 確認發明人名單真實正確；
- (2) 代表發明人等向國立臺灣大學提出並續行美國臨時申請案(Provisional Application) 或各國之正式專利申請案的校內申請程序；
- (3) 代表發明人等依「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」、「國立臺灣大學研發成果衍生新創企業實施要點」之相關規定，統籌及履行發明人等之義務，並行使發明人等之權利；
- (4) 代表支付、收受，並統籌分配發明人等之專利費用負擔與權益收入；
- (5) 代表發明人等就專利是否繼續申請或維護，表示意見。

發明人等亦同意仍將盡力配合及協助本技術之專利申請與推廣授權事務，且當發明人之間基於本技術發生法律爭議而以國立臺灣大學為被告時，訴訟相關費用由發明人等自行負擔。

此致

國立臺灣大學

*發明人： 1.   (親簽) 2021年 7月 10日

2. _____ (親簽) _____年____月____日

3. _____ (親簽) _____年____月____日

4. _____ (親簽) _____年____月____日

(*) 應簽署者包含亦列為發明人之提案人；2. 本同意書所述之「發明人」，包含專利法中所稱之發明人、新型創作人，與設計人；3. 如有需要，請自行增列)

中華民國 2021 年 7 月 10 日

附件四、技術說明表



氧化鈰粉體製備技術

提案人：呂宗昕 教授

單位：國立臺灣大學 化學工程學系/研究所

簡歷：日本東京工業大學無機材料系博士

研究室網頁：<http://homepage.ntu.edu.tw/~d01524001/index.ht>

提案人：呂宗昕教授

市場及需求：

本技術係關於一種使用於化學機械研磨(Chemical-Mechanical Polishing, CMP)的材料。化學機械研磨為半導體製程中重要技術，而該研磨過程中需要特殊陶瓷粉體，其形貌及大小需精確控制，以提高半導體製程之良率。

技術摘要(含成果)：

本技術利用特殊聚合物材料進行反應，可合成型態均一之氧化鈰粉體，並且具有粒徑分佈均勻以及分散性良好等優點。相較於市面粒徑較大之氧化鈰粉體，透過本技術合成之氧化鈰粉體，可避免研磨對象表面的損傷，有效進行研磨。

優勢：

透過此聚合體技術可合成粒徑分佈均勻、分散性良好、型態均一的氧化鈰粉體，有利於降低製造成本，以及避免研磨時造成研磨物體表面受損。

競爭產品：

既往氧化鈰粉體粒徑粗大、型態不均勻、且容易團聚，會造成晶片刮傷，且降低半導體製程良率。

專利現況：

- (1)本技術將申請中華民國專利。
- (2)本技術團隊教授具有研究陶瓷材料二十年以上經驗。
- (3)本研究團隊具有十年以上研究螢光材料經驗。
- (4)本技術團隊教授為本校特聘教授，並獲得多次國科會傑出研究獎。

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ordiac@ntu.edu.tw



Preparation technology of cerium oxide powders

PI : Prof. Chung-Hsin Lu

Department of Chemical Engineering, National Taiwan U.

Experience:

Ph.D., Tokyo Institute of Technology, Department of Inorganic Materials

<http://homepage.ntu.edu.tw/~d01524001/index.html>

Market Needs:

This technology is related to a kind of materials used in Chemical-Mechanical Polishing (CMP) process. CMP process is an important technology used in the semiconductor process. In this process, special ceramic powders with well-controlled morphology and sizes are required for increasing the yield of the processes.

Our Technology:

and good dispersion ability. The powders synthesized by this technology can avoid the surface damage of the object and polish the object effectively.

Strength:

This technology using polymer can synthesize cerium oxide powders with uniform size, good dispersion, and uniform morphology. We can reduce the production cost and reduce the damage of the objects during polishing.

Competing Products:

The previous cerium oxide has large particle sizes, non-uniform morphology, agglomeration problems. This kind of particles will case the damage of the wafers and reduce the yield of productions.

Intellectual Properties:

- (1) This technology will be filed as a patent in our country.
- (2) The professor in the research team has studied ceramic materials for more than twenty years.
- (3) The research team has studied phosphors materials for more than ten years.
- (4) The professor in the research team is a distinguished professor at NTU, and has obtained many rewards from NSC.

Contact (do not need to fill out):

Center for Industry-Academia Collaboration, NTU

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ordiac@ntu.edu.tw

附件五、國立臺灣大學教師自費申請專利合約書(一式兩份)

本校案號：06B-210203
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）

呂宗昕（以下簡稱乙方）

乙方利用甲方資源所獲得之研發成果「氧化銻粉體製備技術」（下稱本成果），其智慧財產權屬甲方所有，惟乙方經甲方同意得依中華民國之專利法申請專利，約定下列條款，依誠實信用原則共同遵守：

- 一、乙方將本成果以甲方名義（中國大陸地區專利案除外）自費辦理專利申請及維護事宜（下稱本專利）。乙方申請本專利後，與本專利有關之專利申請相關費用、技術移轉（或授權）、權益分配及其他相關事宜，應依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理，乙方應負協助之義務。
- 二、乙方同意依資助機關之相關規定，對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務，未經甲方事前書面同意，不終止專利申請或專利維護案，亦不將專利申請權或專利權授權他人利用，或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。
乙方並同意若不願繼續申請或維護專利權時，應事先以書面通知甲方，並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。
- 三、如申請/維護的為中國大陸地區專利案，甲方得視需要要求乙方將專利申請權（或專利權）無條件讓與甲方，並應於接獲甲方通知後，於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜，且不得另行要求任何報酬。
- 四、乙方明瞭並知悉，因本專利未呈報資助機關即自行終止維護而產生之任何賠償或追償作業，乙方同意負責賠償或辦理相關費用繳回之作業。乙方如違反本合約及資助機關相關規定之情事，願承擔相關法令及契約責任；乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定，除應承擔一切法律責任外，甲方並得視情節輕重要求損害賠償。
- 五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止，但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內，乙方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行

申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。

七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)

代 表 人：管中閔

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號

乙 方：呂宗昕   (簽章)

任職單位：化工系

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號台大化工系

中華民國 100 年 7 月 10 日

附件五、國立臺灣大學教師自費申請專利合約書(一式兩份)

本校案號：06B-210703
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）

呂宗昕（以下簡稱乙方）

乙方利用甲方資源所獲得之研發成果「氧化鈾粉體製備技術」（下稱本成果），其智慧財產權屬甲方所有，惟乙方經甲方同意得依中華民國之專利法申請專利，約定下列條款，依誠實信用原則共同遵守：

- 一、乙方將本成果以甲方名義（中國大陸地區專利案除外）自費辦理專利申請及維護事宜（下稱本專利）。乙方申請本專利後，與本專利有關之專利申請相關費用、技術移轉（或授權）、權益分配及其他相關事宜，應依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理，乙方應負協助之義務。
- 二、乙方同意依資助機關之相關規定，對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務，未經甲方事前書面同意，不終止專利申請或專利維護案，亦不將專利申請權或專利權授權他人利用，或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。
乙方並同意若不願繼續申請或維護專利權時，應事先以書面通知甲方，並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。
- 三、如申請/維護的為中國大陸地區專利案，甲方得視需要要求乙方將專利申請權（或專利權）無條件讓與甲方，並應於接獲甲方通知後，於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜，且不得另行要求任何報酬。
- 四、乙方明瞭並知悉，因本專利未呈報資助機關即自行終止維護而產生之任何賠償或追償作業，乙方同意負責賠償或辦理相關費用繳回之作業。乙方如違反本合約及資助機關相關規定之情事，願承擔相關法令及契約責任；乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定，除應承擔一切法律責任外，甲方並得視情節輕重要求損害賠償。
- 五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止，但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內，乙方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行

申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。

七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)

代表人：管中閔

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號

乙 方：呂宗昕

任職單位：化工系

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號台大化工系

  (簽章)

中華民國 100 年 7 月 10 日